

产品3.0平台 - 功能 #4913

3.0正维5.8G整机问题

2026-02-24 14:45 - 陈晓盟

状态:	新建	开始日期:	2026-02-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵燕明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
经正维测试问题：			
1、经测试PAPR为8dB,正维FPGA夹具数据源为8.3dB,怀疑CFR削峰过大,导致EVM恶化值变高,需支持调整PAPR版本			
2、板卡在5.8GHz频段下,存在本振泄露问题,需提供版本复测			
3、在EVM VS Symbo1窗口下,在第二个5ms周期起始位,可以看到明显的EVM峰值较高问题,怀疑是信号到空口时延未对齐			